

課題番号 : F-13-WS-0034  
利用形態 : 技術相談  
利用課題名 (日本語) : 3次元 LSI のハイブリッド接合に関する研究  
Program Title (in English) : Investigation of hybrid bonding for 3D LSIs  
利用者名 (日本語) : 大山 真輝  
Username (in English) : Maki Oyama  
所属名 (日本語) : 早稲田大学 基幹理工学部 電子システム学科  
Affiliation (in English) : Department of Electronic and Photonic Systems, School of Fundamental Science. and Engineering, Waseda University.

#### 1. 概要 (Summary) :

3次元 LSI の接合技術として、チップ間やウエハ間を電氣的に接続するマイクロバンプと封止目的として充填されるアンダーフィルを同時に接合・接着するハイブリッド接合が注目を集めている。そのハイブリッド接合の  $10\mu\text{m}$  のファインピッチのマイクロバンプへの適用を目指す。

相談の結果、この作製では、マイクロバンプの高さの均一性がキーとなることが分かり、今後、添加剤を加えためっき法などでマイクロバンプの作製を検討する。

#### 2. 実験 (Experimental) :

なし。

#### 3. 結果と考察 (Results and Discussion) :

なし。

#### 4. その他・特記事項 (Others) :

なし。

#### 5. 論文・学会発表 (Publication/Presentation)

なし。

#### 6. 関連特許 (Patent)

なし。